

「第39回 インターネプコンジャパン」に出展致します

— 会期:2025年1月22日(水)~24日(金) —

是非、弊社ブースへお立ち寄りください [1ホール E1-5]

先進の技術で不可能を可能に！

～ニホンゲンマのスーパーファインテクノロジー～

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、来る2025年1月22日(水)～24日(金)東京ビッグサイト東ホールにおいて開催されます「第39回インターネプコンジャパン」に出展する運びとなりました。ここに謹んでご案内申し上げます。

弊社ブースでは、

「3D構造組立へ！微細ディスペンス用はんだペースト」「接合部の超微細化へ！超微細はんだ粉末Type9(1～5μm)適用製品」「車載、高信頼性製品に対応！超低ボイドペースト」「スルーホールリフローに対応！レーザー用ペースト」「半導体パッケージ向け製品！水溶性はんだペースト、エポキシ樹脂系はんだペースト」「組立後の洗浄工程削減へ！残渣レス、ギ酸対応はんだペースト、残渣レスフラックス」「環境負荷低減！低融点ペースト」等の各種鉛フリー新商品を展示致します。

弊社は、はんだゾーン小間番号：1ホールE1-5にて出展致しております。ご多忙のこととは存じますが、是非この機会にご来場賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ご来場にはお一人様1枚招待券が必要です。招待券はこちらよりダウンロードをお願い致します。《<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1215647296699121-QN5>》

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

株式会社ニホンゲンマ
代表取締役社長 川崎 誠

追記 下記アポイントメント票を用意致しました。恐れ入りますがご来場予定日時をご記入の上、出来ましたら2025年1月17日までにご返送あるいは、弊社営業担当者までご返却願いたく宜しくお願い申し上げます。

キリトリ

TO: 株式会社ニホンゲンマ
営業部 木元宛

返送先 FAX : 03-3863-5722
E-MAIL : kimoto@genma.co.jp

アポイントメント票

貴社名 _____ TEL: _____
FAX: _____

ご芳名 _____ 役職: _____

ご来場予定日時: 2025年1月 日 時



エレクトロニクス時代を支える

株式会社 ニホンゲンマ